

证券代码: 603061

证券简称: 金海通

公告编号: 2026-040

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于全资子公司购买土地使用权暨投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资基本情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第二届董事会战略委员会第四次会议、于2026年2月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目的议案》，同意公司在上海市青浦区华新镇投资建设“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”。项目总投资不超过4亿元，建设集生产、研发与综合办公为一体的生产运营中心。

具体内容详见公司2026年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于全资子公司投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目的公告》（公告编号：2026-017）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司全资子公司上海澜博半导体设备有限公司（以下简称“上海澜博”）与上海市青浦区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：

1、合同双方

出让人：上海市青浦区规划和自然资源局

受让人：上海澜博半导体设备有限公司

2、地块编号：青浦区华新镇 QPS6-0102 单元 13B-06 地块

3、出让宗地面积：21,001.76 平方米

4、宗地位置：上海市青浦区华新镇，东至：规划地块，南至：规划 13B-07 地块，西至：尤家港路，北至：施海河

5、成交价格：5,041 万元

6、土地用途：工业用地，科研设计用地

7、使用年限：工业用地：20年，科研设计用地：50年

三、对公司的影响

上海澜博本次取得上述土地使用权，将用于上海澜博半导体设备制造中心建设项目，该项目若顺利建成并达产，可以在提高公司产品测试分选机制造及公司运营能力的同时，进一步增强公司的综合服务能力及核心竞争能力。

本次竞买土地使用权，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司后续将按合同约定推进项目建设，项目建设过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年5月21日